



TS-TIR® 700-09系列 是一款高效碳基导热垫片，结合高导热碳纤维与高分子硅胶材料，以先进工艺精准分布导热通路，实现优异的热传导性能，有效降低界面热阻并提升散热效率。其具备超薄轻量 and 机械柔韧性，适用于5G设备、高性能芯片及其他高热通量应用。

特性

- 》良好的热传导率 9W/mK
- 》极低热阻抗
- 》可在低压下工作
- 》非绝缘型材料
- 》无表面粘性

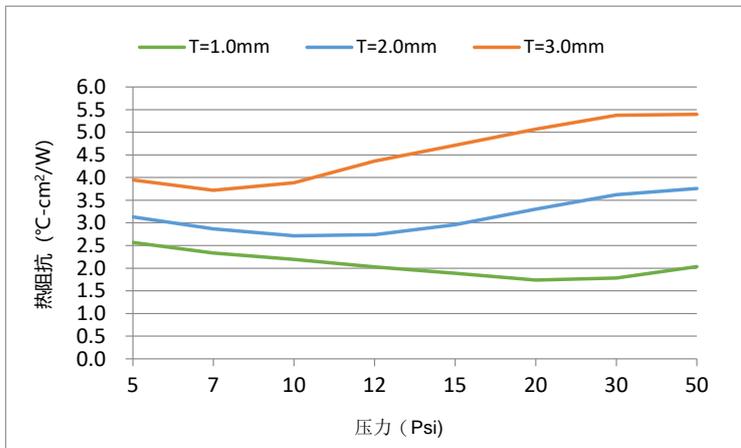
应用

- 》芯片与散热模组之间
- 》5G通讯设备
- 》光电行业
- 》可穿戴设备

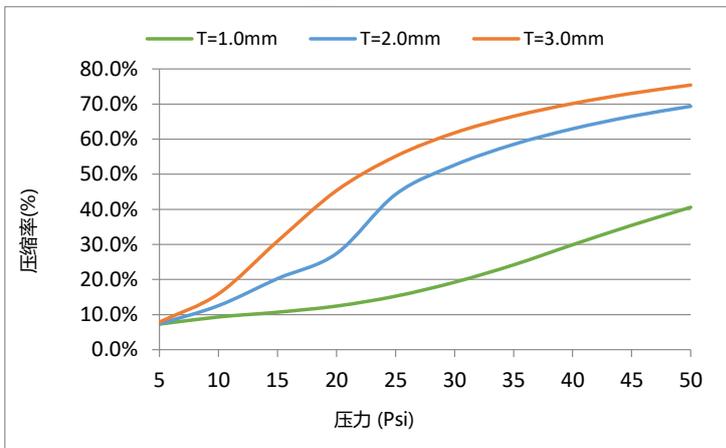
TS-TIR® 700-09 系列碳基导热垫系列特性表

产品特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	Visual
结构&成份	碳纤维填充硅橡胶	-
厚度范围	0.04"~0.20" (1.0~5.0mm)	ASTM D374
硬度 Shore OO	55±10	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	2.1	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40~200	内部测试
导热系数 W/mK	9.0	ASTM D5470
比热容 J/(g·°C)	0.93	ASTM E1269 @25°C
阻燃等级	V-0	UL94
RoHS	符合	IEC62321

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.04" (1.0mm), 0.06" (1.5mm), 0.08" (2.0mm), 0.10" (2.5mm), 0.12" (3.0mm)

标准尺寸: 1.97" × 1.97" (50.0mm × 50.0mm)

TIR® 700-09系列产品可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。如需更大尺寸，请与本公司联系。
欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

